

LAGENAUFBAU HDI (Standard)		12 - Lagen Kerne: 0,10 mm Cu 17.5/17.5 µm	
HDI12_2+8+2_1,25_17.5		WE-Artikel Nr.: 2 + 8 + 2	
KUNDE:			

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE					[µm]	[µm]	
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1) 1 x 1080	12		
							60	
2	VSK1			Folie	12 µm	1 x 1080	30	
							66	
3	2				17.5 µm		16	
				0,100 mm			100	
4	3				17.5 µm		16	
						2 x 1080	134	
5	4				17.5 µm		16	
				0,100 mm			100	
6	5				17.5 µm		16	
						2 x 1080	134	
7	6			17.5 µm		16		
			0,100 mm			100		
8	7			17.5 µm		16		
					2 x 1080	134		
9	8			17.5 µm		16		
			0,100 mm			100		
10	9			17.5 µm		16		
					1 x 1080	66		
11	RSK1		Folie	12 µm	1 x 1080	30		
					1 x 1080	60		
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1) 1 x 1080	12		

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1266

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	1,25	+/-	0,10	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,34	+/-	0,13	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,40	+/-	0,15	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	
28.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	Seite: 8+